

Einzigartiges Mikrowellen Inline System für die Chipherstellung

PVA TePla präsentiert das weltweit einzige Plasma Mikrowellen Inline System für die Behandlung von einzelnen Substraten in der Halbleiter-Chipverpackung

(Feldkirchen – 23.03.2006) - PVA TePla stellt in Nürnberg auf der vom 30.05. bis 01.06.2006 stattfindenden SMT/HYBRID/PACKAGING das neu entwickelte Plasma System 80 vor.

Die Besonderheit bei dieser Produktionsanlage liegt in der einzigartigen Wirkung des Mikrowellen Plasmas. In das neue System fließt das mehr als 20 jährige Expertenwissen von PVA TePla ein. Es wurde für die Behandlung von Einzelsubstraten entwickelt, insbesondere von Chipträgern bei der Montage von Halbleiterbauelementen.

Das Hard- und Softwaredesign reflektiert den neuesten Stand der Technik und erfüllt alle Anforderungen vollautomatischer Inline Fertigung – einfach zu integrieren, höchster Durchsatz und Produktivität zu einem äußerst attraktiven Preis.

In der Tat erfüllt das neue PVA TePla System alle Vorzüge anspruchsvoller Mikrowellen Plasmatechnologie für die Feinstreinigung von Einzelsubstraten im Chip Packaging. Das Mikrowellen Inline System 80 bietet schnelle und effektive Oberflächenreinigung und zeichnet sich durch eine unübertroffene Gleichmäßigkeit der Plasmawirkung aus, ohne die Oberfläche im geringsten zu beschädigen. Darüber hinaus tritt in der Prozesskammer, entgegen Wettbewerbssystemen, keine störende UV-Strahlung auf. All diese Besonderheiten des anspruchsvollen Mikrowellen Plasmas garantieren erheblich verbesserte Behandlungsergebnisse und sorgen für höchste Produktionsraten.

Das Mikrowellen Inline System von PVA TePla beweist seine Stärke vor dem Prozess des Vergießens und dem Drahtbonden. Prozesszeiten für die Aktivierung der Lötstoppmasken von weit unter 10 Sekunden ermöglichen überwältigend kurze Durchlaufzeiten bei hervorragend gleichmäßiger Wirkung der Plasmabehandlung.

Presseinformation



Nr. 5/06
24. März 2006
Seite 2

Die weiteren ausschlaggebenden Vorzüge des Plasma System 80: Die Prozesskammer ist leicht skalierbar und kann sämtliche Arten von Chipträgern aufnehmen wie Chip Scale Packages, Plastik Ball Grid Arrays und FlexBGAs bis hin zu Hybriden, COB Substraten und alle Typen von metallischen Leadframes. Das System ist in der Lage selbst größte Boats und Trays zu behandeln.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

PVA TePla AG

Geschäftsbereich Plasma-Anlagen

Wolfgang Petasch

Hans Riedl-Strasse 5

85622 Feldkirchen

Phone: +49 (89) 90503-125

Fax: +49 (089) 90503-185

E-mail: plasma@pvatepla.com